



张新平 教授、硕士生导师、博士生导师

华南理工大学 材料科学与工程学院 机敏材料与电子封装团队负责人  
广东省电子封装材料与可靠性工程技术研究中心主任



电话: (20) 22236396

电邮: mexzhang@scut.edu.cn

主页: www2.scut.edu.cn/smep/

### 招生专业与类型

学术博士: 金属材料加工工程

学术硕士: 金属材料加工工程/专业硕士: 材料工程(金属)

招生方向: 电子封装材料与工程及可靠性、形状记忆合金及相变、材料计算与加工模拟及工程仿真

### 教育与工作经历

- 1986 西安交通大学 工学学士
- 1989 西安交通大学 工学硕士
- 1993 西安交通大学 工学博士
- 1989-1996 西安交通大学, 助教/讲师/副教授
- 1996-1998 柏林工业大学, 洪堡学者/研究员
- 1998-2004 悉尼大学, 高级研究员/研究小组组长
- 2004-至今 华南理工大学, 教授、硕士/博士生导师
- 2004-至今 多次长期客座悉尼大学、鲁尔-波鸿大学等

### 科研工作

**研究方向:** 电子封装材料与工程及可靠性、形状记忆合金及相变、先进材料连接与可靠性、材料计算与加工模拟及工程仿真

**科研业绩:** 发表一作和通讯作者等论文360余篇(英文论文270余篇), 包括 Acta Materialia, Scripta Materialia, Journal of Applied Physics, Materials Science & Engineering-A, Materials Letters, Journal Alloys & Compounds, Computational Materials Science, Journal of Electronic Materials, Microelectronics Reliability等国际知名期刊论文140多篇, 电子封装领域顶级国际会议(ECTC)论文10余篇及品牌会议(ESTC/ICEPT)论文80余篇, 出版学术著作1部(26万字)、著作章节16万字, 申请专利36项(28项已授权), 5项成果获技术转移并产业化。

**研究资助:** 主持和承担国家自然科学基金10项(含联合)、澳大利亚国家研究基金重点项目1项、德国洪堡基金2项和大众汽车基金1项、教育部人才基金2项、广东省基金和科技计划7项、省市企业项目40余项, 经费逾1500万。

1994年起于西安交通大学开始招收和培养研究生, 1996年9出国前已培养硕士3名。1996-2004任职德国柏林工大和澳大利亚悉尼大学期间协助培养博士2名及硕士3名, 指导博士后3名; 2004年6月实质性回国作为高层次引进人才被聘为华南理工大学教授和博导, 创建了“机敏材料与电子封装”研究组和“广东省电子封装材料与可靠性工程技术研究中心”; 2004年入选教育部首批“新世纪优秀人才”, 2006年6月再获洪堡基金赴德工作; 曾任悉尼大学名誉研究员和访问教授(2004-2013)、鲁尔-波鸿大学客座教授(2006.07-10)、中山大学兼职教授(2007.01-)。近年来60余次做国际会议邀请报告、国际会议咨询委员和会场主席以及在国际知名大学和研究机构做报告。

**国际交流:** 与美国马里兰大学和Ohio州立大学、澳大利亚悉尼大学、德国鲁尔-波鸿大学、英国拉夫堡大学、比利时安特卫普大学等有长期合作, 近年来人员交流(包括研究生联培)10多人次。

**人才培养:** 培养毕业硕士60名、博士20名, 博士后6名; 近年指导学生5次获电子封装国际会议最佳/杰出论文奖并获数以千计美元奖金; 近年毕业生几乎均就业于华为、海思、中兴通讯、大疆、汇顶科技、TP-Link、美国应用材料(AM)、长江存储等电子信息产品设计与制造领域顶尖公司。

